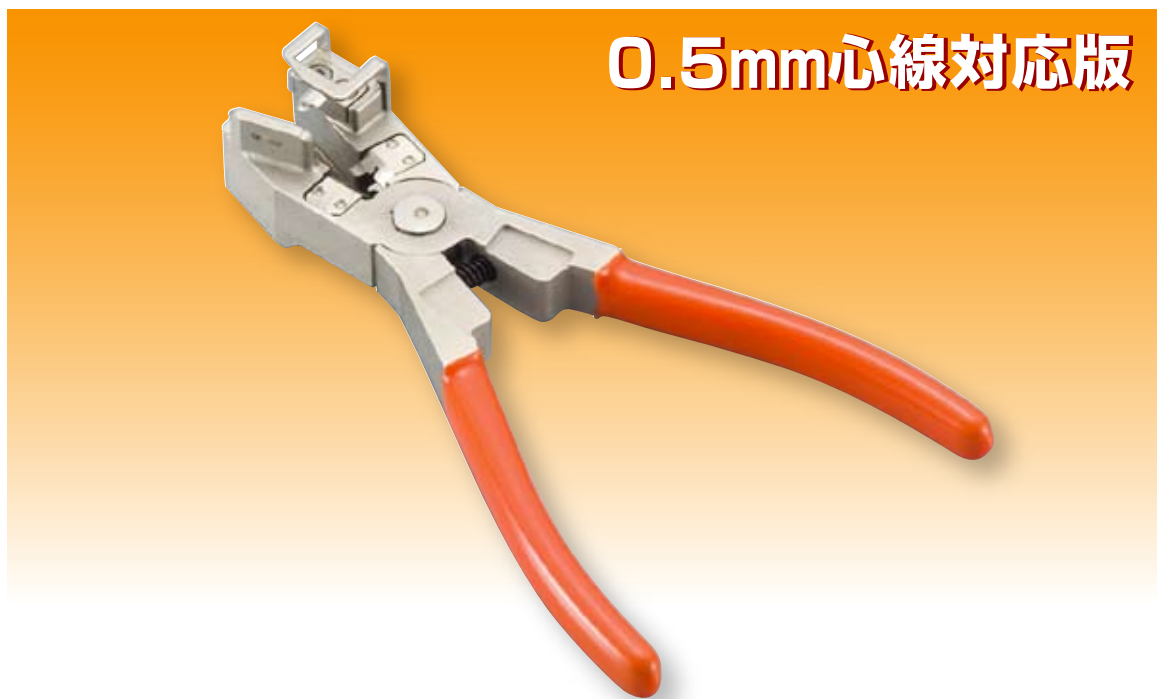


ケーブル端末処理工具



用途

FSCおよびFAS(現地付外被把持)コネクタ取付時の**ケーブル端末処理**(0.5mmファイバ心線の口出し)と**支持線分離**の2作業を1つにまとめたマルチ工具です。

特長

すべての刃は長時間ご使用いただくことを考慮して、材質の選定および熱処理を施しています。

【ケーブル端末処理】

1. **0.5mmファイバ心線の単心ドロップケーブル**の端末で、ファイバ心線を傷つけることなく口出しすることができます。
2. **インドアケーブル**にも対応できます。

【支持線分離】

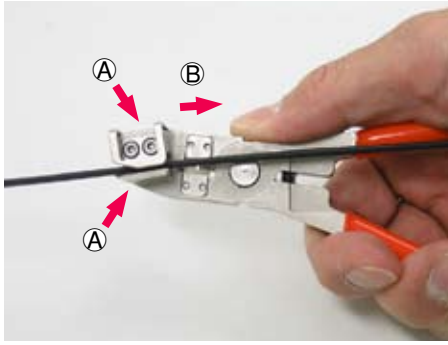
1. ケーブルガイドを設けることでケーブルと支持線の分離品質を高めています。
2. ケーブルにバリが残らず、曲げ癖もつきません。
3. 刃先を保護カバーで覆うことで、使用時・搬送時の安全性を高めています。

仕様

品名	寸法(mm)	重量(g)
ケーブル端末処理工具	140×90×25	230

ケーブル端末処理工具取扱説明

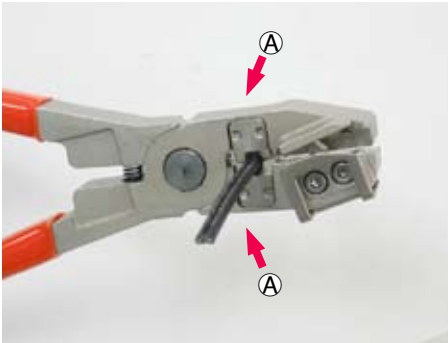
手順
1



支持線分離

- ① ケーブルの分離開始位置をガイドにセットする。
- ② ガイド(下凸部)にケーブルの支持線部を外側に、ファイバ部を内側に乗せる。
- ③ グリップを握り、ケーブルの分離開始位置に刃先を下ろす。【矢印A方向】
- ④ グリップを握った状態で、左手でケーブルを保持し、右手で本工具を手前にケーブルと平行に引く。【矢印B方向】

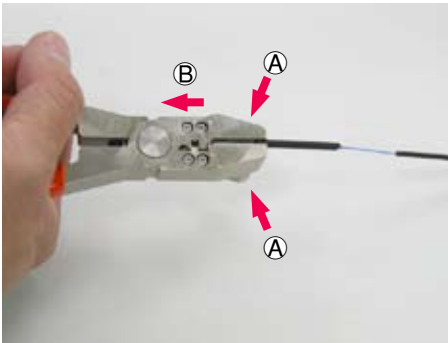
手順
2



ケーブル端末処理 Ⅰ

- ① ケーブルの口出し開始位置をガイド部にセットする。
- ② ガイド(上凸部、下凹部)にケーブルを確実に乗せる。
- ③ グリップを握り、ケーブルの口出し開始位置に刃先を下ろす。
- ④ グリップを最後まで握り、切断完了。【矢印A方向】

手順
3



ケーブル端末処理 Ⅱ

- ① ケーブルの口出し側を本工具で握る。【矢印A方向】
- ② グリップを握った状態で、左手でケーブルを保持し、右手で本工具を手前にケーブルと平行に引く。【矢印B方向】



住電ハイプレジジョン株式会社

www.shpc.co.jp

■お問い合わせは
東京事務所(営業部)
〒105-0004 東京都港区新橋6-19-19
TEL. 03-5401-0811 FAX. 03-5472-7677
E-Mail. eigyo1@shpc.co.jp